

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ РАЗУПОРЯДОЧЕНИЯ GaAs
ПРИ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ АЗОТА

Акимченко И. П., Алещенко Ю. А., Дымова Н. Н.,
Заветова М., Краснопевцев В. В.

Вхождение изовалентных примесей в решетку GaAs может привести к изменению кинетики отжига радиационных дефектов и эффективности электрической активации имплантированных легирующих примесей при последующей термообработке, к торможению процесса образования дислокационных петель и уменьшению скорости движения дислокаций. Наиболее существенного воздействия на твердофазные реакции в GaAs можно ожидать от внедрения легких элементов V группы.

В настоящей работе методами оптического поглощения вблизи края фундаментального поглощения, ИК спектроскопии и комбинационного рассеяния света, а также электронной дифракции исследовалось влияние имплантации ионов N на разупорядочение монокристаллического полуизолирующего GaAs и на восстановление решетки при последующем термическом или быстром световом отжиге.

Имплантация ионов N с энергией 100 кэВ (доза от 10^{15} до $3 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-2}$, плотность тока ионного пучка $0.5 \div 1.2 \text{ мкA}/\text{см}^2$) осуществлялась с обеих сторон полированных пластин GaAs толщиной 200 мкм при комнатной температуре. Последующий термический отжиг ($300 \div 800^\circ\text{C}$, 1 ч) проводился с защитной пленкой из SiO_2 или Al_2O_3 ; быстрый световой отжиг (галогенная лампа, $500 \div 700^\circ\text{C}$, $1.5 \div 3$ с) — без пассивации поверхности.

Сразу после внедрения ионов N в ИК спектре поглощения наблюдается слабый и широкий максимум при 480 см^{-1} , обусловленный локальными колебаниями [1]. После отжига при 300°C интенсивность максимума возрастает. Концентрация N, найденная по максимуму при 480 см^{-1} [2], составляет $\sim 10^{18} \text{ см}^{-3}$; это значение меньше расчетной средней концентрации внедренного N ($2.6 \cdot 10^{20} \text{ см}^{-3}$ для дозы 10^{16} см^{-2}). Тот факт, что максимум расположен при 480 см^{-1} , свидетельствует о вхождении части атомов N в узлы As.

На рис. 1 представлена спектральная зависимость оптической плотности ad , полученная после внедрения в GaAs трех доз ионов: $3 \cdot 10^{15}$, $1 \cdot 10^{16}$ и $3 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-2}$. В результате имплантации ионов N вблизи края появляются экспоненциальные хвосты поглощения, которые простираются в ИК область до 0.5 эВ. При этом с увеличением дозы ионов уменьшаются и коэффициент поглощения α , и котангенс угла наклона отрезков прямых E (от 0.52 до 0.2 эВ). При дозе $3 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$ зависимость ad описывается двумя отрезками прямой ($E=0.52$ и 0.2 эВ), в то время как при более высоких дозах остается один отрезок с $E < 0.52$ эВ. Эти данные указывают на упорядочение решетки в процессе имплантации N, поскольку степень разупорядочения структуры в соответствии с моделью, развитой в [3], возрастает с увеличением параметра E . Надо отметить, что при имплантации ионов Ar (доза $3 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$) образуется аморфный слой, которому отвечает зависимость ad от $h\nu$ с параметром $E=-0.16$ эВ [3]. В результате последующего отжига при $300 \div 500^\circ\text{C}$ экспоненциальные хвосты в спектрах поглощения почти полностью исчезают.

На кристаллическую или аморфную фазу в слое GaAs_N указывают также данные о комбинационном рассеянии света. На рис. 2 приведены спектры комбинационного рассеяния, полученные на тех же образцах GaAs_N. Максимумы комбинационного рассеяния, обусловленные LO- и TO-фононами решетки GaAs для дозы $3 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$ (спектр 2), значительно меньше по интенсивности, чем в исходном кристалле (спектр 1); с увеличением дозы ионов N высота максимумов при 292 и 268 см⁻¹ для LO- и TO-фононов растет, а полуширина уменьшается. При этом смещение LO- и TO-мод в длинноволновую область тем меньше, чем выше доза (спектры 2—4). Таким образом, результаты исследования комбинационного рассеяния света также свидетельствуют об упорядочении решетки GaAs в процессе внедрения N, причем образования аморфной фазы не наблюдается. Пики LO- и TO-фононов

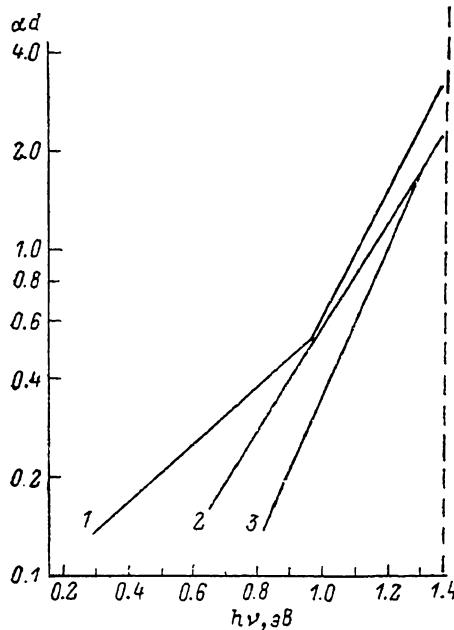


Рис. 1. Спектральная зависимость оптической плотности αd для GaAs после внедрения ионов N с энергией 100 кэВ.

Доза ионов, см⁻²: 1 — $3 \cdot 10^{15}$, 2 — 10^{16} , 3 — $3 \cdot 10^{16}$. Штриховая линия — спектр для исходного кристалла.

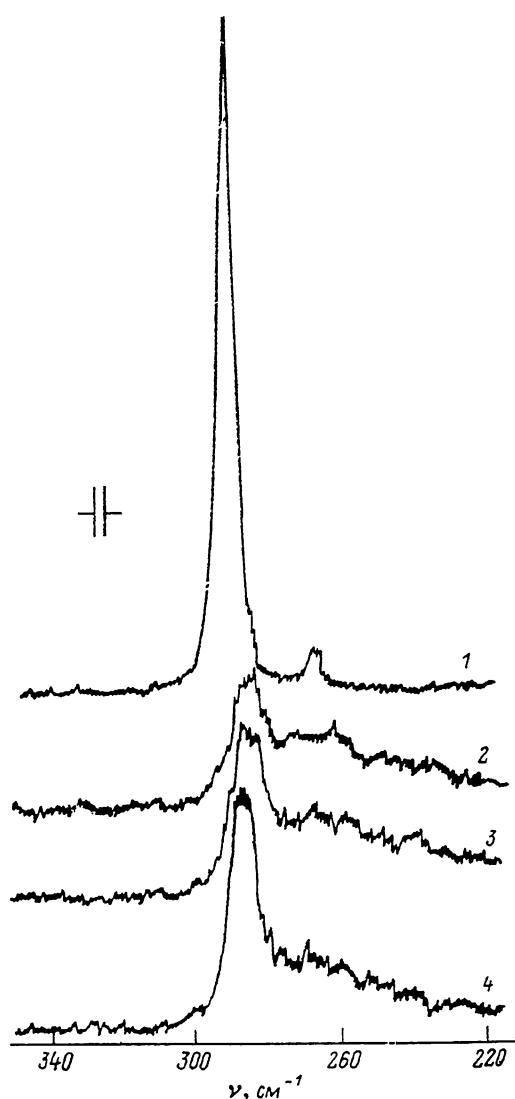


Рис. Спектр комбинационного рассеяния света в GaAs до (1) и после (2—4) внедрения ионов N с энергией 100 кэВ.

Доза, см⁻²: 2 — $3 \cdot 10^{15}$, 3 — 10^{16} , 4 — $3 \cdot 10^{16}$. Максимумы при 292 и 268 см⁻¹ (1) обусловлены LO- и TO-фононами.

нов в аморфной фазе GaAs лежат при 255 и 146 см⁻¹ и отчетливо видны после имплантации ионов Ar с энергией 100 кэВ (доза $3 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$).

Выводы, сделанные относительно структуры слоев GaAs_N, подтверждаются данными электронной дифракции, полученными для слоя толщиной 5–10 нм: наиболее разупорядоченным (вплоть до появления аморфной фазы) оказался образец с минимальной дозой имплантированных ионов N ($3 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$).

В процессе последующего отжига при 300–500 °C экспоненциальные хвосты в спектрах поглощения (рис. 1) почти исчезают, а интенсивность, по-

ложение и полуширина максимумов в спектрах комбинационного рассеяния становятся близкими к наблюдаемым в исходных кристаллах.

Таким образом, ионное внедрение азота при дозе 10^{16} см^{-2} и выше сопровождается упорядочением кристаллической структуры GaAs без последующего отжига. Наиболее существенное восстановление решетки происходит при внедрении дозы $3 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-2}$, когда концентрация N в максимуме профиля распределения примеси достигает $\sim 1.5 \cdot 10^{21} \text{ см}^{-3}$ ($3 \div 4$ ат%).

Внедрение ускоренных ионов в кристаллическую решетку происходит в условиях, далеких от термодинамического равновесия. При дозах ионов азота 10^{16} см^{-2} и выше концентрация простых радиационных дефектов решетки в GaAs (вакансии и междуузельные атомы Ga и As, их несложные комплексы), образованных при торможении легких атомов N, становится очень высокой и стремится к насыщению; большинство внедренных атомов N сразу, после того как они израсходовали свою кинетическую энергию и остановились в междуузельях, с высокой вероятностью захватывается вакансиями атомов As. Этому процессу способствует ряд особенностей атомов N при их имплантации в GaAs. Во-первых, атомы N обладают значительной по сравнению с атомами As электроотрицательностью (7.5 и 5.0 эВ) и в условиях высокой генерации неравновесных электронно-дырочных пар ($\sim 1.5 \cdot 10^{22} \text{ см}^{-3} \cdot \text{с}^{-1}$ для ионов с энергией 100 кэВ при плотности тока ионного пучка $1 \text{ мкА/см}^2 = 0.625 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$) легко захватывают по одному электрону и становятся ионами N⁻. Во-вторых, вакансия As из-за большого эффективного отрицательного заряда атома As в GaAs (0.46) заряжена положительно, что облегчает захват этой вакансии иона N⁻. В-третьих, хотя ковалентные радиусы атомов N и As (0.070 и 0.121 нм) сильно различаются, что затрудняет вхождение N в GaAs в термодинамически равновесных условиях, захват иона N⁻ вакансии атома As (радиус N⁻ составляет ~ 0.104 нм) приводит, по-видимому, к повышению энергии связи N⁻ с Ga-окружением; во всяком случае локальная мода N в узле As характеризуется большей энергией, чем LO-фононы GaAs (~ 0.059 и 0.036 мэВ соответственно). Причем столь высокое значение энергии локальной моды трудно объяснить одним лишь уменьшением приведенной массы осциллятора. Акцепторная природа N в узле As подтверждается экспериментально наблюдаемой компенсацией Si-доноров азотом, внедренным в GaAs [4]. В-четвертых, существенное восстановление структуры в области профиля распределения имплантированного азота приводит к усиленной миграции подвижных дефектов к поверхности мишени, что обусловливает повышение степени разупорядочения (вплоть до аморфизации) тонкого приповерхностного слоя (не более 5 нм, по данным электронной дифракции), и обеднению этой области междуузельными атомами Ga и As [5].

Итак, можно ожидать, что в условиях ионной имплантации (высокой скорости генерации неравновесных электронно-дырочных пар, высокой концентрации вакансий и т. п.) при температурах не более $100 \div 120^\circ\text{C}$ вхождение азота в решетку GaAs существенно облегчается; замещение атомов As атомами N сопровождается упорядочением структуры, компенсацией донорных центров и т. д.

Авторы признательны В. А. Дравину за ионное внедрение азота, А. Е. Городецкому за электронную микроскопию образцов, А. А. Демкову за полезное обсуждение работы.

Список литературы

- [1] Kachare A. H., Spitzer W. G., Kahan A., Euler F. K., Whatley T. A. // J. Appl. Phys. 1973. V. 44. N 10. P. 4393—4399.
- [2] Zavetova M., Pangrac J., Riede V., Kamba S. // VI Čs. Konf. o tenkých vrstvach. 1987. II. dil. Mariánské Lázně. C. 173—174.
- [3] Wesch W., Götz G. // Phys. St. Sol. (a). 1986. V. 94. N 2. P. 745—766.
- [4] Duncan W. M., Matteson S. // J. Appl. Phys. 1984. V. 56. N 4. P. 1059—1062.
- [5] Ahmed N. A. G., Christodoulides C. E., Carter G. // Rad. Eff. 1980. V. 52. N 3-4. P. 211—224.